

**附件六**

**G組高明鐵盃-智慧製造應用競賽-企劃書 評分方式說明**

**各項目分數請直接寫入後方 內，由行銷統一結算分數，謝謝您**

1. 摘要 (符合技術關聯及特點%):20%)

**分**

含背景簡介、設計構想、設計原理、製作可行性與預期實作結果等概要陳述，須至少符合8項技術關聯及特點之一。(精密製造應用、彈性製造應用、跨領域技術整合、智慧感測、智慧控制、多系統物聯及控制、智慧機器人、虛實合一應用)，且能讓評審在短時間內抓到此專題實作之重點，如論文之abstract。

1. 設計概念 (創新性:25%)

**分**

作品設計之創意性等說明

1. 系統架構 (符合技術關聯及特點:20%)

**分**

如架構圖、系統功能描述、電路控制邏輯及軟硬體規劃等之說明。

1. 設計簡圖 (使用公司零組件之主題比重:25%)

**分**

含機構設計圖、設計原理說明、3D Cad圖檔、設計計算資料。以上設計資料需**完整**呈現高明鐵免費提供之零組件資訊(以設計圖顯示安裝位置及表列品名、規格、數量等)

1. 機電控制(使用公司零組件之主題比重:25%)

**分**

如作品軟硬體系統規格說明與效能描述。

1. 作品特色與價值說明(產業運用價值:20%)

**分**

本作品特色、效益與未來目標說明

1. 結論(產業運用價值:20%)

**分**

1. 總結(書面完整性:10%)

**分**

**\*總評: (由行銷企劃部門統計最後分數)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **創新性** | **符合技術關聯及特點** | **產業運用價值** | **使用公司零組件之主題比重** | **書面完整性** |
| 比例 | 25% | 20% | 20% | 25% | 10% |
| 書面(40%) |  |  |  |  |  |
| 實體(60%) |  |  |  |  |  |